

「SEMICON TAIWAN 2025 京都パビリオン」装飾等業務 仕様書

1 委託業務名

「SEMICON TAIWAN 2025 京都パビリオン」装飾等業務

2 委託業務の目的

京都府、京都市及び公益財団法人京都産業 21（以下、「実行委員会」という）では、海外展開を目指す府内企業の製品・サービスを、グローバルマーケット関係者へ直接 PR・商談する機会を確保するため、世界最大級の半導体関連展示会である、「SEMICON TAIWAN 2025」内に、京都パビリオンを設置します。

パビリオンでは、京都企業の出展や交流イベント開催により、台湾を中心に、世界中の企業や投資家等の展示会来場者との商談等を通じ、ビジネスマッチングや京都府施策への誘因を図ることを目的に出展します。

当該業務は、京都パビリオンに係る装飾等の一連の業務を行うもの。

3 出展する国際展示会の概要

【展示会の概要】

- ・ 展示会名：SEMICON TAIWAN 2025
- ・ 会 期：2025 年 9 月 10 日（水）～12 日（金） 10 時～17 時
※2025 年 9 月 12 日（金）のみ 10 時～16 時
搬入日：9 月 6 日（土） 12 時～17 時、9 月 7 日（日）、8 日（月） 6 時～17 時
- ・ 会 場：台湾 台北市 TaiNEX1&2
- ・ 主 催：SEMI
- ・ 概 要：期間中は、各業界の研究者や著名な経営者等が登壇するカンファレンスセッションや半導体関連企業のブースが集結する展示会等を開催。世界各国で開催されているが、その中でも、台湾は世界的な半導体設計・製造の拠点であるため、本展示会の重要度は高い。
- ・ 2024 実績：25 カ国から 1,100 を超える出展者
3,700 以上のブース
訪問者 85,000 人

4 パビリオンでの出展内容、全体装飾概要

- ・ 壁面やブース上部に京都を想起させるイメージ、サインを配した全体装飾を行う。
- ・ 通路側から反対側面に、出展企業等の荷物等を置く施錠可能なバックヤードを設ける。

5 委託業務の内容

- (1) 上記の展示会に伴う出展会場の装飾に係るデザイン・工事等一切の業務。
- (2) 上記(1)に係る資材等の搬入・設置・撤去・電気工事等の業務。
※搬入・設置は現地時間の 2025 年 9 月 8 日（月）10 時までに完了するものとする。
- (3) 本展示会事務局が定める装飾規定及び規則に準じ発生する、電気料金や搬入・撤去に関わる調整や経費の支払い等の業務。※出展者希望の追加分に関しては、出展者説明会等で説明を行うオプション費用等で追加徴収することも可。
- (4) 出展者や製品情報を記載した来場広報用チラシの作成・印刷業務。紙媒体での納品は、会期前日に会場での納品とする。別途チラシは pdf と ai データで納品すること。
- (5) 実行委員会が主催する出展者説明会に参加し、ブース概要やレイアウト、追加オプション等の説明を行うこと。出展者説明会は、6/中～6/末頃で調整予定。
- (6) その他、出展者からの装飾や SHIPPING に関する相談対応
- (7) 会期中に実行委員会または出展者から上記(1)に係る業務について補正等の指示があった場合には、速やかにその指示に従い業務を行う。

(8) 開催期間中の通訳の手配 (3名程度、日英又は日中に対応できること)

6 ブース仕様について

【ブースサイズ等について】

- (1) ブース名称 (社名版記載名) : KYOTO
- (2) ブース全体面積 : 約 36 m² (間口 12 メートル×奥行 3 メートル)
※ブースサイズは、(別添)フロアプランに記載の「Q6135、Q6137、Q6139、Q6141」
- (3) ブースでの出展者数 : 6 社を出展。ブース内に 5 社出展可能な出展スペースを確保。その他、行政や特別出展用に、前述 5 ブースと同規模のブースを 1 ブース用意 (計 6 ブース) すること。
- (4) 上記(3)出展効果を最大化できる空間・配置とすること。

【装飾内容】

- ◆装飾方針 : SEMICON TAIWAN×京都のイメージに合う全体デザインとする。
 - ◆装飾コンセプト
 - ・遠くからでも場所がわかるブース名称の掲示 どこからでも京都とわかること
 - ・照明を活用し、十分な明るさを確保
 - ◆全体装飾と基本備品
 - ・全体装飾や基本備品は提案するデザインに従い、リスト化すること。
- <出展ブース・・・6 ブース分設営>
- ・基本備品は出展者分の展示台 (施錠+収納付き)、資料/動画投影用モニター、社名版、バックパネル、電源 (2 ロコンセント)。
 - ・電気工事の施工を行うこと (一次側・二次側幹線工事)。
 - ・本展示会事務局が定める装飾規定及び規則に準ずる仕様であること。(別添 出展マニュアル等参照)
- ◆デザイン作成において実行委員会からの提供物 ※契約締結後にデータ提供
 - ・全体装飾に必要なデータ等は、京都府や出展企業と都度相談し、可能な範囲で提供する。
 - ・実行委員会構成団体の文字・字体及びロゴ等についても支給。

7 出展者や製品情報を記載した来場広報用チラシの作成・印刷業務

- ・チラシデザイン構成や出展者との記載項目の調整含むチラシ作成業務。
- ・チラシサイズ : A4 サイズ両面カラーで作成
- ・印刷部数 : 800 枚。 ※納品形式は 100 枚ごとに梱包すること。
- ・納品場所/納品期限 : pdf・ai データは会期 1 か月前を目途に納品。印刷チラシは会期前日搬入日に会場に納品すること。

8 出展者パスの登録 : 会場搬入出に必要な出展者情報は実行委員会と調整し、登録すること

9 個人情報の保護

本委託業務を通じて取得した個人情報については、京都府個人情報保護条例に基づき、適正に管理し、取り扱うこと。

10 その他

本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、実行委員会と受託者が協議して定めるものとする。

本業務は実行委員会の委託業務であり、業務の成果については実行委員会に帰属する。

11 お問合せ先

AI 時代に向けた京都ものづくり産業の成長戦略実行委員会

(事務局)

〒600-8813

京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター
公益財団法人京都産業21イノベーション推進部統括担当内

TEL: 075-315-8677

E-MAIL: semicon@ki21.jp